

ひとわざ(一技)名: 半導体加工装置を使用した切削加工

1. 概要

シリコンウェハをはじめ、金属、セラミック、ガラエポ、ガラス等の難切削材料の切断の受託が可能です。特に、加工精度においては、カットライン精度:  $\pm 3 \mu\text{m}$ 、チッピング幅:  $10 \mu\text{m}$ 以下と高精度の加工が可能です。

また、低コスト、短納期で対応いたします。

切削加工前の裏面研削及び切削加工後のトレイ詰めや、真空梱包等、柔軟に対応いたします。

写真・図(要点説明)

ダイシング(切削加工)

ダイヤモンドブレード

超純水

製品をダイヤモンドブレードによって個片状態に切り分けます。溝入れ加工も可能です。

加工前

加工後

カットライン精度:  $\pm 3 \mu\text{m}$   
チッピング幅:  $10 \mu\text{m}$ 以下

**シリコンウェハをはじめ、金属、セラミック、ガラエポ、ガラス等  
難切削材料を高精度に加工可能!**

2. 企業概況

フリガナ	カブシキガイシャ ニチワコウギョウ	フリガナ	テラサワ シングル
会社名	株式会社 ニチワ工業	代表者名	寺澤 茂
		フリガナ	ハシバ カズヒロ
		窓口担当	橋場 和宏
事業内容	半導体、難切削材の研削、切削加工	URL	<a href="http://www.nichiwak.co.jp">http://www.nichiwak.co.jp</a>
主要製品	精密研削・切削加工、情報画像サプライ品の製造		
フリガナ	ナガノケン チノシ ホンマチヒガシ		
住所	〒391-0003 長野県茅野市本町東3-17		
電話/FAX	0266-72-6840	E-mail	HPから問い合わせください
資本金(百万円)	15	設立年月	1970年3月
		売上(百万円)	—
		従業員数	125

特記事項(①特許取得・各種認証等取得状況②提供できる価値及び応用分野③SDGsへの取り組み 他

①・ISO9001: 2015年度版取得済み

・ISO14001: 2015年度版取得済み

②半導体用の高精度設備を多数そろえておりますので、上記加工だけでなく、

裏面研削、研磨、レーザーマーキング、ダイシング、各種トレイ詰め、仕様に応じた梱包状態で出荷が可能です。

また、超純水製造設備を所有しておりますので、洗浄作業等も可能です。